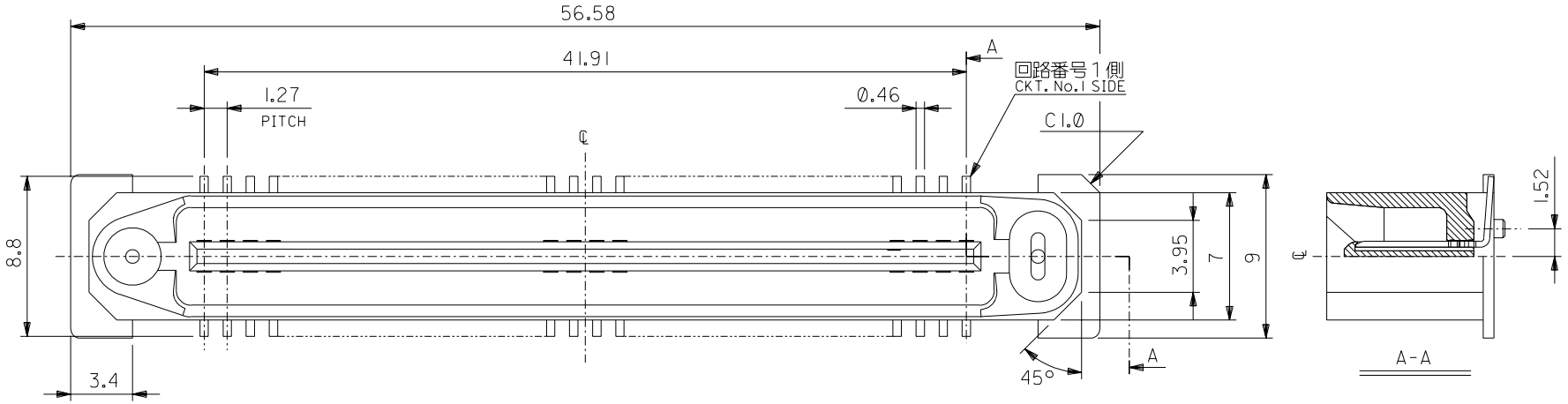

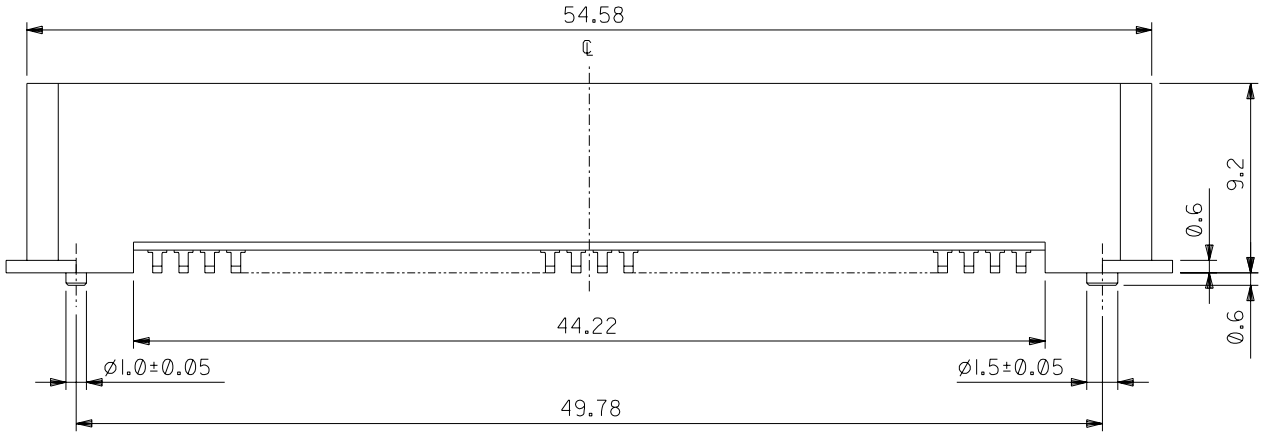

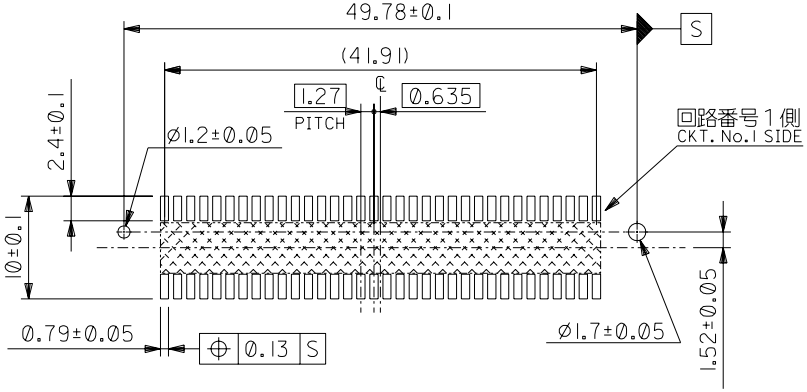

推奨基板寸法
RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT
(SCALE 2:1)

VIA HOLE 禁止領域
NO VIA HOLES IN THIS AREA.

注記
NOTES:

1. 材質
MATERIAL
ハウジング：ガラス入りＬＣＰ、黒色、ＵＬ９４Ｖ－０
HOUSING : G.F.LCP , BLACK , UL94V-0
ターミナル：燐青銅
TERMINAL : PHOSPHOR BRONZE

2. メッキ仕様
PLATING
ターミナル： 接点部 ：金メッキ 0.76μmMIN.
TERMINAL : CONTACT AREA : GOLD 0.76 MICROMETER MINIMUM.
半田付け部：錫メッキ 1.0μmMIN.
SOLDER TAIL AREA : TIN 1.0 MICROMETER MINIMUM.
下地メッキ：ニッケルメッキ 1.5μmMIN.
UNDER-PLATING : NICKEL 1.5 MICROMETER MINIMUM.

3.

71660-7068	PS-71660/55087
嵌合相手 MATED CONN.	納入仕様書 PRODUCT SPECIFICATION

4. テール平坦度： 0.1 MAX.
TAILS COPLANARITY:0.1 MAX.

5. 本製品は５５０８７－６８１１の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 55087-6811.

55087-**19	55087-6819	68
MODEL No.	MATERIAL No.	CKTS.

一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
角度 ANGLE	±3°				
30 以上 OVER	±0.3				
10 以上 30 未満 OVER UNDER	±0.25				
10 未満 UNDER	±0.2	0	新規作成 RELEASED (J2004-4038)	H.K K.T	'04/04/28

材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES
仕上げ FINISH	注記参照 SEE NOTES
適用電線範囲 WIRE RANGE	#
被覆外径 INS. RANGE	#
DRAWN BY '04/04/28	H.KAWABATA
CHK'D BY '04/04/28	K.TOJO
APP'D BY '04/04/28	H. Sasao
尺度 SCALE	4 : 1

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
EBBI 50D VERTICAL
BLIND MATE CONN.
SMT PLUG HS'G ASSY
-LEAD FREE-

DWG. NO. SD-55087-001 REV 0

DWG. NO. SD-55087-001

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

SD-55087-001.S01

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

EN-0IC(032)MXJ-32